



MB-CuSP / CuSP BOLZEN BILLETS

BEZEICHNUNG

Phosphor-desoxidierte Kupferlegierung mit Schwefelzusatz.

SPEZIFIKATIONEN

- Hohe elektrische und thermische Leitfähigkeit
- Gute Zerspanbarkeit
- Gute Warm- und Kaltumformbarkeit
- Hohe Härte nach Verformungsprozessen
- Gute Korrosionsbeständigkeit

ANWENDUNG

- Spanabhebende Bearbeitung (Bohren, Fräsen, Automattendrehteile)
- Elektrotechnische Bauteile, gute Leitfähigkeit
- Düsen zum Schweißen und für Schneidbrenner
- Alternative zu CuTeP (CW118C)
- Weiterverarbeitung zu Produkten der Normen
ASTM B124
ASTM B283
ASTM B301

DESIGNATION

Phosphorus deoxidized and sulfur bearing copper alloy.

SPECIFICATIONS

- Very good electrical and thermal conductivity
- Good machining properties
- CuSP can be cold and hot worked
- Good hardness after processing
- Good corrosion resistance

APPLICATION

- Machining applications (drilling, milling, automatically turned parts)
- General electrical components with high conductivity
- Nozzles for welding and gas cutting
- Alternative to CuTeP (CW118C)
- Processing to products according to
ASTM B124
ASTM B283
ASTM B301

CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG

CHEMICAL COMPOSITION

PARAMETER	CW114C / CUSP NACH CEN/TS 13388	UNS C14700
Cu + S + P	≥ 99,90 %	≥ 99,90 %
S	2000 - 7000 ppm	2000 - 5000 ppm
P	30 - 120 ppm	20 - 50 ppm
Verunreinigungen Impurities	< 0,1%	-
Beständigkeit gegen Wasserstoffversprödung Resistance against hydrogenembrittlement	ja yes	ja yes